


MARDI 5 JUIN		MERCREDI 6 JUIN		JEUDI 7 JUIN		VENDREDI 8 JUIN	
8:00 – 8:45 : Inscription							
8:45 – 9:00 : Ouverture et présentation de l'Atelier		8:30 – 10:00		8:30 – 10:00		8:30 – 10:00	
9:00 – 12:00		Session n°3 Analyse de défaillance des VLSI	Micro-atelier n°1 Interconnexions, report et packaging	Tutorial 3 MEMS	Micro-atelier n°3 Localisation et caractérisation électrique de défauts dans les VLSI & composants III-V	Tutorial 4 Composants Passifs	Session n°6 Nouveaux objets Nouveaux défis
		10:30 – 12:00		10:30 – 12:00		10:30 – 12:00	
Session n°1 La contrefaçon	Tutorial 1 Interconnexions PCB	Session n°3 Analyse de défaillance des VLSI	Micro-atelier n°1 Interconnexions, report et packaging	Tutorial 3 MEMS	Micro-atelier n°3 Localisation et caractérisation électrique de défauts dans les VLSI & composants III-V	Tutorial 4 Composants Passifs	Session n°6 Nouveaux objets Nouveaux défis
Déjeuner		Déjeuner		Déjeuner		12:00 – 13:00 : BILAN	
14:00 – 15:30		14:00 – 15:30		14:00 – 15:30		Déjeuner	
Session n°2 Interconnexions : report et packaging	Tutorial 2 Techniques d'analyse de défaillance des VLSI	Session n°4 Technologies et mécanismes de défaillance des composants de puissance	Micro-atelier n°2 Analyse et caractérisation physique des VLSI & composants III-V	Session n°5 Défiabilisation des composants en utilisation	Micro-atelier n°3 Localisation et caractérisation électrique de défauts dans les VLSI & composants III-V	14:30 : Départ	
16:00 – 17:30		16:00 – 17:30		16:00 – 17:30		<p style="text-align: center;">ATELIER 2012 13^{ÈME} Atelier</p> 	
Session n°2 Interconnexions : report et packaging	Tutorial 2 Techniques d'analyse de défaillance des VLSI	Session n°4 Technologies et mécanismes de défaillance des composants de puissance	Micro-atelier n°2 Analyse et caractérisation physique des VLSI & composants III-V	Session n°5 Défiabilisation des composants en utilisation	Micro-atelier n°3 Localisation et caractérisation électrique de défauts dans les VLSI & composants III-V		

ATELIER 2012

13^{ÈME} Atelier

«ANALYSE ET MÉCANISMES DE DÉFAILLANCE
DES COMPOSANTS POUR L'ÉLECTRONIQUE »

Village Club Belambra « Les Tuquets » Seignosse (40)
5 juin au 8 juin 2012

ORGANISE PAR

anadef

Association loi 1901

Analyse de défaillance & technologie
des composants électroniques
www.anadef.org

avec le concours de

Adera Service